

115學年度進修部 半導體工程與材料系 碩士在職專班課程規劃表

第一學年(115)						第二學年(116)					
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期	
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數
院 必 修	專題討論	2	2	2	2	院 必 修					
	研究方法與論文寫作			2	2						
	小計	2	2	4	4		小計	0	0	0	0
專 業 必 修						專 業 必 修	論文	3	3	3	3
	小計	0	0	0	0		小計	3	3	3	3
專 業 選 修	高等物理冶金	3	3			專 業 選 修	半導體化學材料應用及檢測	3	3		
	半導體元件導讀	3	3				奈米封裝技術	3	3		
	高等高分子化學	3	3				先進半導體技術	3	3		
	陶瓷材料特論			3	3		電子顯微鏡學			3	3
	薄膜工程導讀			3	3		專利檢索與寫作			3	3
	電化學分析技術與應用			3	3		光譜分析			3	3

【科目類別】		學分	時數
專業科目	院必修	6	6
	專業必修	6	6
	專業选修	18	18
合計		30	30

注意事項：

1. 畢業應修學分為30學分；含必修：12學分，選修：18學分（本系專業選修至少12學分以上，其餘可跨系）
2. 每學期修習學分：下限為1學分。
3. 「論文」必修6學分，俟口試通過後，一次給予6學分。
4. 學生修習遠距教學學分(含抵免學分)總數，以畢業總學分數之二分之一為限。
5. 表列選修課程僅供參考，依實際狀況調整。
6. 本表建立於115年3月18日

